附件5-4

**2024年“中国芯”关键技术优秀产品申报表（集成电路材料）**

**企业信息（以下信息均为必填项）**

|  |  |
| --- | --- |
| **企业名称****（中英文）** |  |
| **企业简介** |  |
| **企业人员规模** | **2023年** |  | **2024年****（上半年）** |  |
| **公司产品销售主要依靠：****□公司自有销售团队 □委托分销代理商 □其他方式** |
| **联系人姓名** |  | **职务** |  |
| **地址** |  | **邮编** |  |
| **座机电话** |  | **手机** |  |
| **E-mail** |  | **传真** |  |
| **公司产品****按应用领域分类**（细分产品至多选1类） | □集成电路材料 | **前道晶圆制造材料**□硅衬底材料□光刻工艺材料（光刻胶、掩模版、光刻辅助材料等）□电子气体（电子大宗气体、电子特气、前驱体等）□湿电子化学品（包括清洗、CMP、电镀等湿法工艺材料）□靶材□其他**后道芯片封装材料**□芯片载体材料（封装基板、Interposer等）□导电互联材料（bumping电镀液、微凸点及助焊剂材料、靶材、键和丝、引线框架等）□切割减薄保护材料（临时键合胶、保护胶带等）□图形工艺光敏材料（PSPI、光刻胶等）□TSV工艺材料□填料封料□粘接材料（贴片胶/膜、焊料等）□热界面材料□其他 |
| **公司应用市场及销售情况** |  | **销售总额（单位：万元）** |
| **2023年全年** | —— |
| **2024年上半年** | —— |
| **2024年全年预计** | —— |
| **市场份额**（注：根据市场总量实际估测） | —— |
| **公司服务客户企业情况** |  | **服务规上客户数量(客户年销售额>2000万元)** | **服务客户数量** |
| **2023年全年** | —— | —— |
| **2024年上半年** | —— | —— |
| **2024年全年预计** | —— | —— |
| **公司全球采购情况** |  | **采购国内企业金额（亿元）** | **采购海外企业金额（亿元）** |
| **2023年全年** |  |  |
| **2024年上半年** |  |  |
| **2024年全年预计**（注：企业所属按总部所在地统计） |  |  |
| **服务供应链情况介绍（包括服务下游客户和采购上游产品情况）** |  |
| **企业规模分类** | □大型 □中型 □小型  |
| **是否为“专精特新”企业** | □是（□国家级 □省级） □否 |
| **融资轮次** |  |
| **外扩需求** | □是 □否 |

**公司产品信息（以下信息均为必填项）**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品名称及****型号** |  |
| **产品服务场景分类** | □晶圆制造 □传统封装 □2.5D/3D等先进封装 □其他：  |
| **主要性能和指标** |  |
| **产品属性** | □内向依赖型（注：按种类和金额算，生产原料同时满足超过50%源于国内企业）□外向依赖型（注：按种类和金额算，生产原料同时满足超过50%源于海外企业）□混合依赖型（注：不属于上述两种情况） |
| **本产品的创新性及所获得的知识产权形式** | **已受理专利数** |  |
| **已获得专利数** |  |
| 注：如有专利，请注明专利号和专利权人并附证明材料见附件。 |
| **本产品的应用市场及销售情况** |  | **销售总额****（单位：万元）** | **销售量****（单位：套）** |
| **自产品推出之时起至今** | —— | —— |
| **2022年全年** | —— | —— |
| **2023年上半年** | —— | —— |
| **2023年全年预计** | —— | —— |
| **市场份额** | （注：根据市场总量实际估测） |
| **对标国外相关产品的情况** |  |
| **法律声明：** **申请单位须保证填写内容的真实性及其参加活动产品的合法性，提供相应的证明材料，并承担由内容的真实性及其参加活动产品的合法性的责任。该活动主办方有权追溯取消该申请单位或该产品的一切参与活动的权利，并保留追求其法律责任的权利。**法人/授权代表签名：企业（盖章） 日期： |